

# 週間半導体ニュース： 5月7日～14日

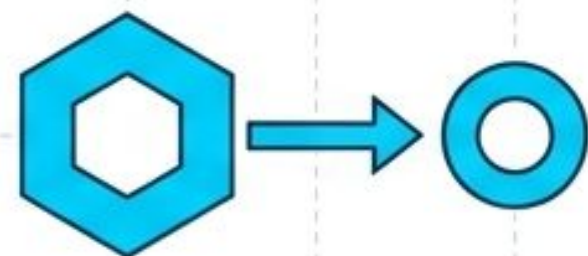
米国主導の再編、AI市場のパラダイムシフト、  
そして地政学的分断の恒久化

[DATE]: 2026年5月 第2週  
[DOCUMENT ID]: STRAT-BRIEF-2605  
[CLASSIFICATION]: CONFIDENTIAL / EXECUTIVE READ



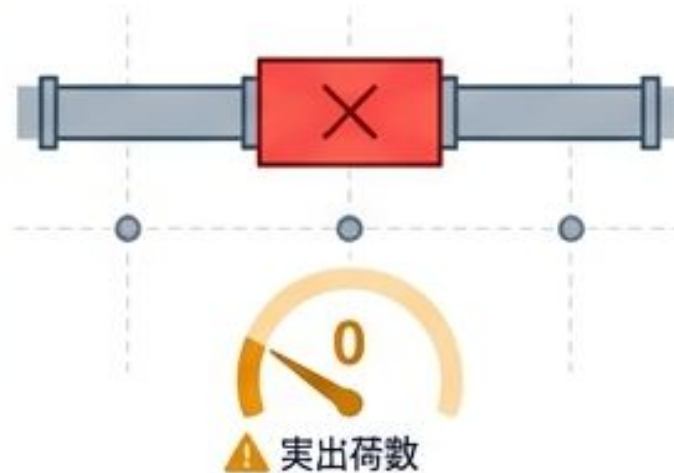
# 業界を牽引する4つの地殻変動（Executive Dashboard）

## 米政策の成果



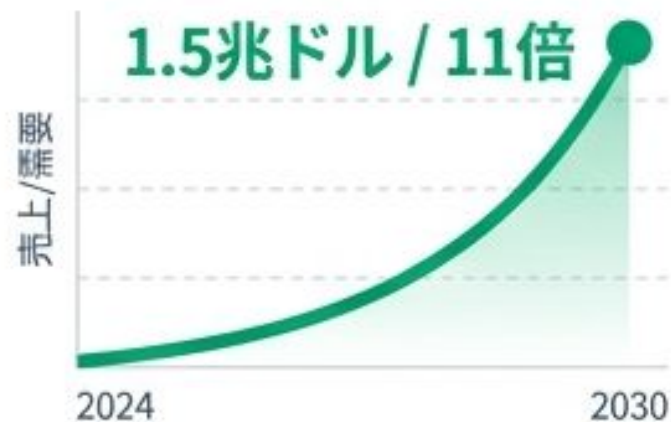
Intel FoundryがApple（M/Aシリーズ）の製造で予備的合意。CHIPS Act戦略の象徴的勝利。

## 地政学の歪み



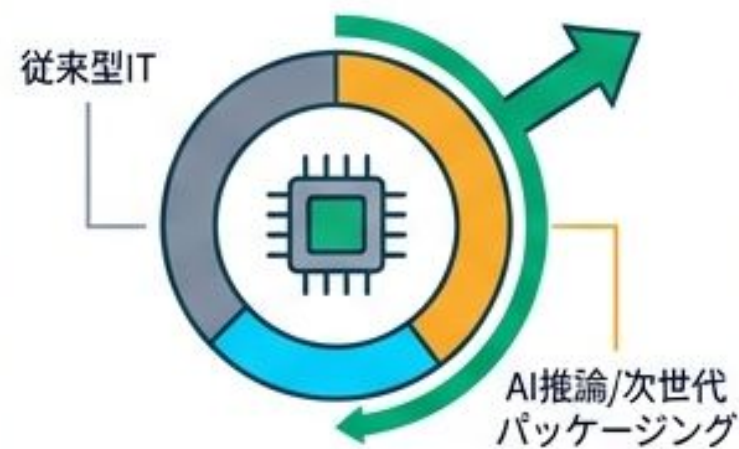
米政府がNVIDIA H200の中国輸出を認可するも、「25%の収益徴収」を課す異例の条件。実出荷はゼロ。

## 需要の構造的成長



TSMCが2030年の売上予測を1.5兆ドルへ上方修正。AIウェハ需要は4年で11倍に。

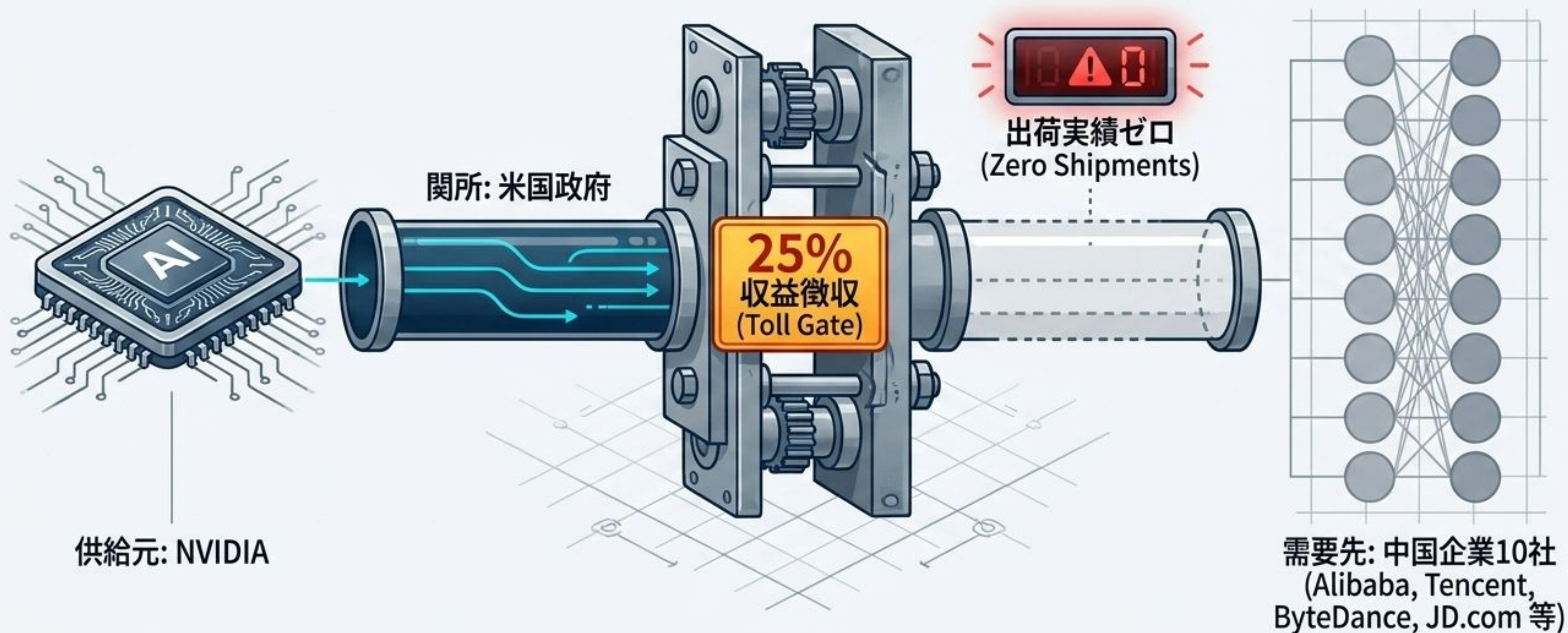
## 投資の専門化



AI推論インフラへのシフト（Fractile 2.2億ドル調達）と、パッケージングのマルチベンダ化。

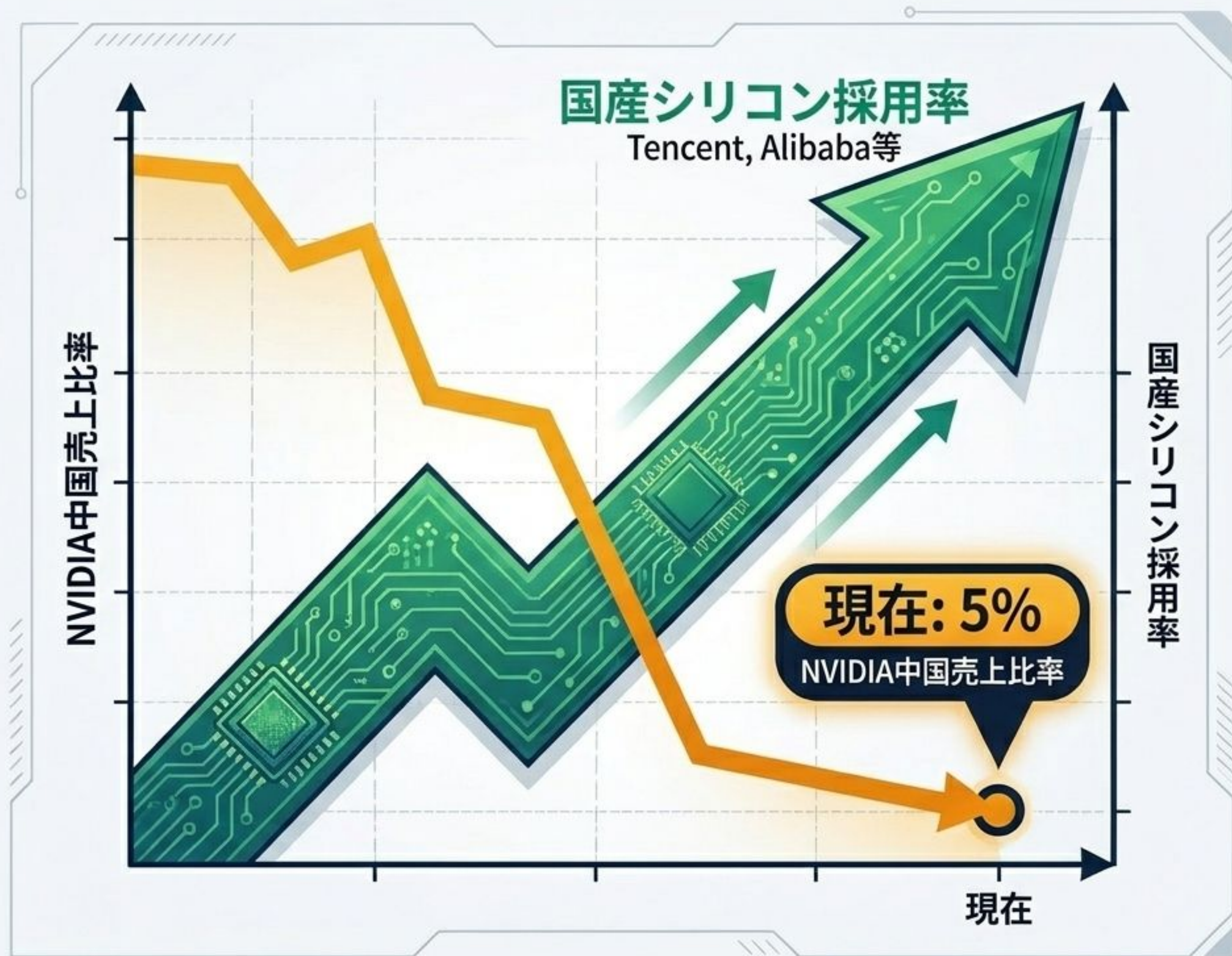
# NVIDIA H200輸出スキームにおける「認可」と「実態」の乖離

1社あたり最大75,000基の購入が認可されたものの、実質的な輸出税（25%）の代用により、エコシステムは完全に停滞。



# 中国市場は NVIDIA依存から 不可逆的に 脱却しつつある

中国当局の指導のもと、  
企業はNVIDIA製品の購入  
を見送り、国産代替品への  
移行プロセスを劇的に加  
速させている。



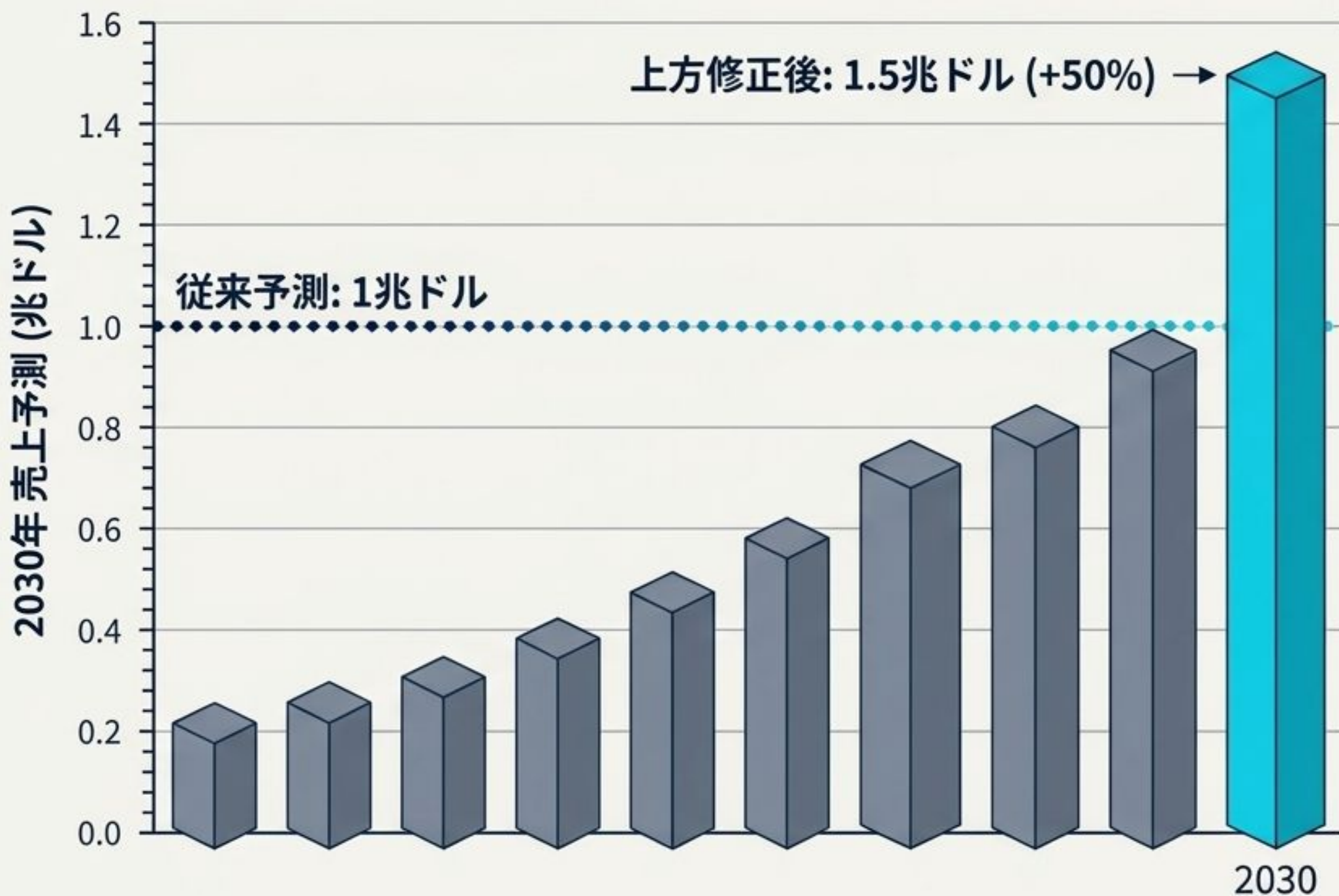
# 米国産業政策の結実：AppleとIntelの戦略的結びつき

単なる企業間取引を超えたCHIPS Act戦略の象徴的勝利。TSMCへの過度な依存軽減に向けた国家主導のエコシステム設計。



# TSMCの強気予測が示す、AI需要の「指数関数的かつ構造的な」成長

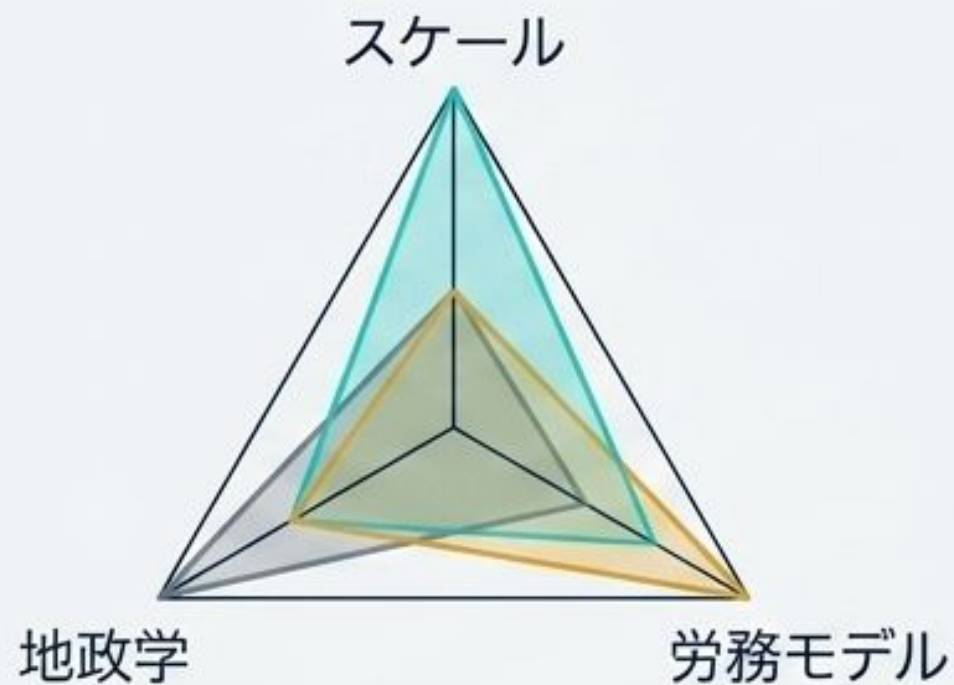
Taiwan Tech Symposiumでの発表は、AIインフラ投資が初期の投機フェーズを終え、持続可能な長期間成長フェーズに突入したことを示唆している。



**313億ドルの設備投資承認**  
(N2, N2P, 先端パッケージング拡大)

# 【Diagnostic Matrix】 主要ファウンドリの競争力とリスク評価

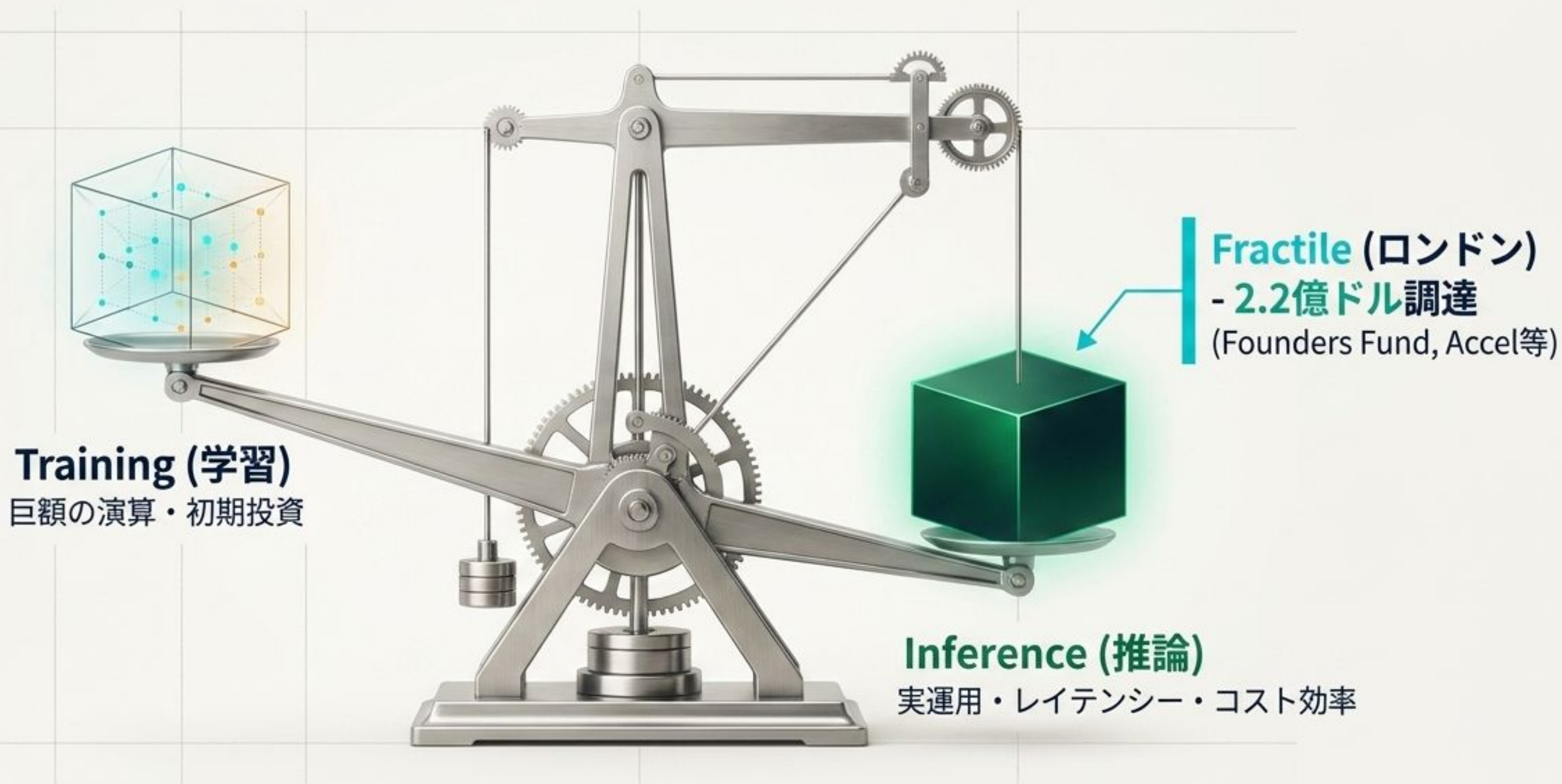
Samsungの労働争議は、TSMCの柔軟な労務モデルとの構造的差異を露呈しており、今後のコスト競争力において重大なリスク要因となる。



評価軸	TSMC	Intel	Samsung
スケールと技術力	● 圧倒的・1.5兆規模	● 18A/14Aへの急追	● 遅れ気味
地政学・政府支援	● 台湾リスク	● 米国CHIPS Actの強力な恩恵	● 中立
労務モデル・コスト	● 非組合型・柔軟・高効率	● 国内回帰のコスト増	● 労働争議・ストライキによる不確実性

# AIインフラ投資の重心移行：「学習 (Training)」から「推論 (Inference)」へ

市場の関心が「モデルを作る」ことから「低コスト・低遅延でモデルを動かす」ことへ移行した証左である。



# スタートアップ投資における「メガ・ラウンド」への極端な資本集中

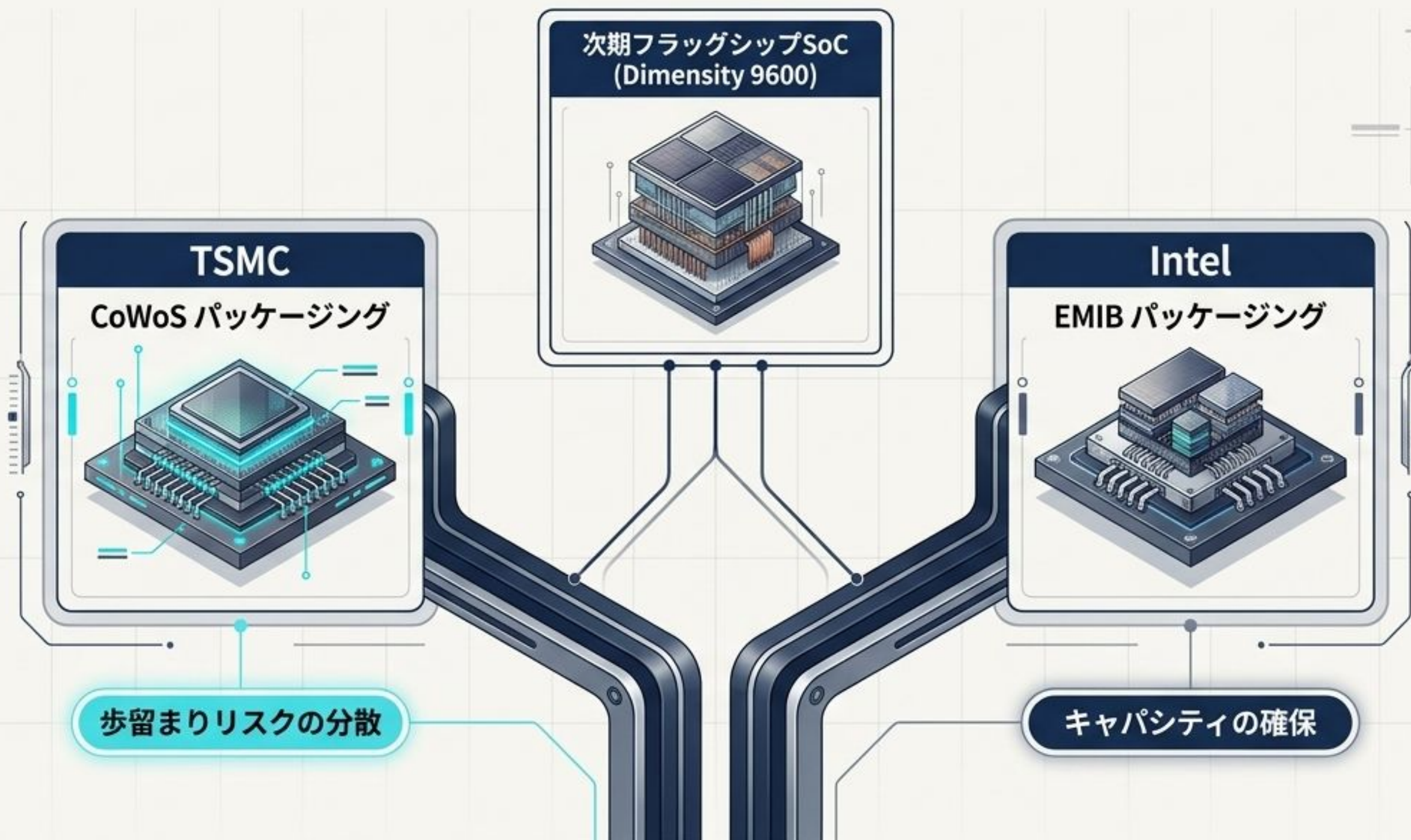
AIインフラ分野への資金流入は続いているものの、上位3案件だけで全体の約7割を占める「Winner-takes-all（勝者総取り）」の構造が鮮明になっている。中堅以下のプレイヤーの淘汰が迫る。

**67%**  
上位3案件のシェア



# チップレット時代のサプライチェーン防衛：「両建て（Hedging）」戦略

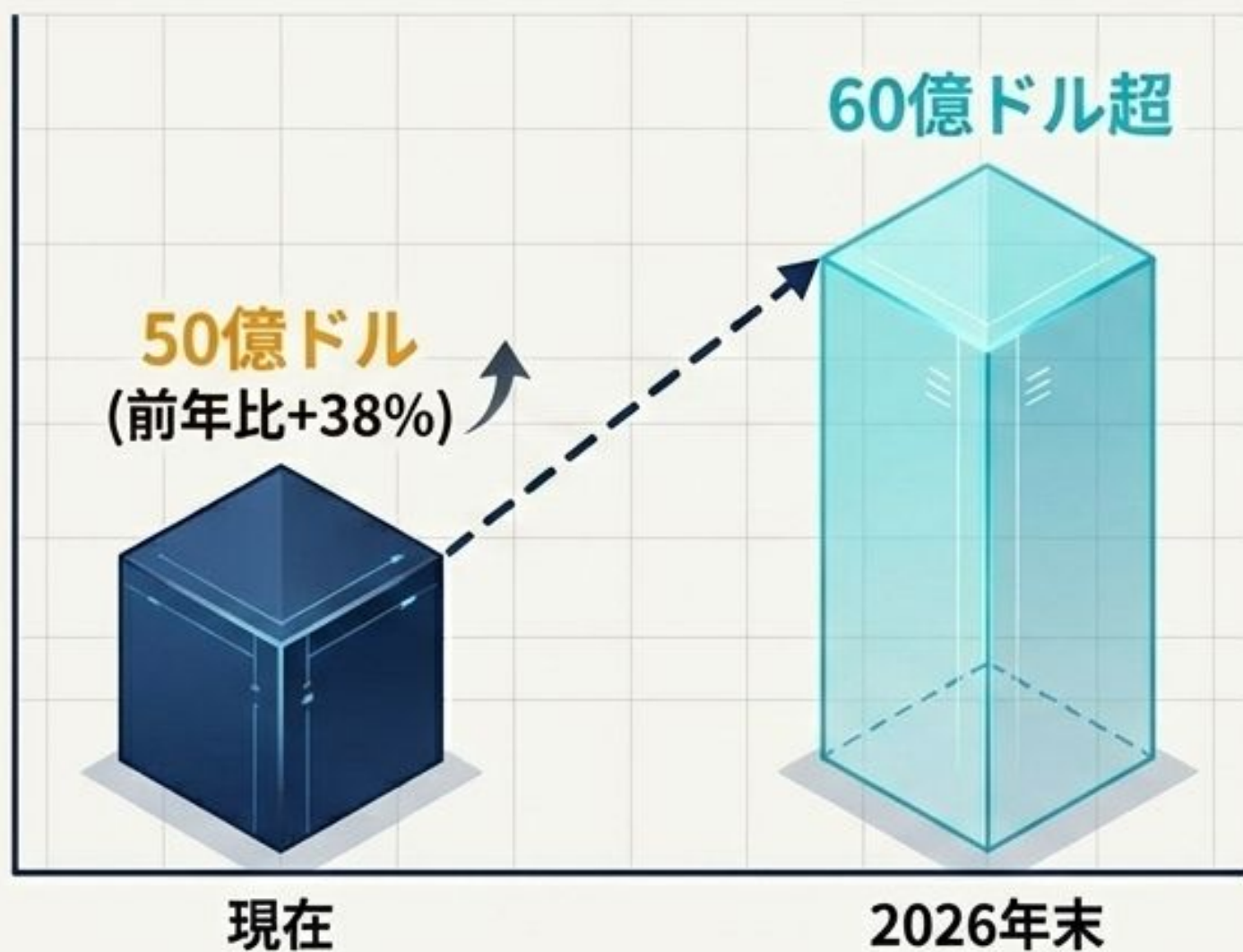
MediaTekは2nmプロセス展開において、TSMCとIntelの先端パッケージング技術を併用する。これは歩留まりリスクの分散と、キャパシティ確保のための必須戦略となっている。



# エッジとモビリティへの拡張がもたらす新たな収益基盤

AIとコネクティビティの恩恵はデータセンターにとどまらない。モビリティとエッジデバイスにおける特殊ノードへの需要が、次なる巨大市場を形成する。

## Qualcomm: 自動車部門売上



## TSMC & Sony 協業



# パワー半導体が切り拓く新興国のEV・電力インフラ

提携を通じたGaN技術のインド市場攻略。次世代パワー半導体は、インフラ急成長国のエネルギー効率化において中核的な役割を果たす。

## インド市場

- EVエコシステム
- 電力エレクトロニクス

Navitas  
Semiconductor &  
Cyrient

Navitas Semiconductor  
& Cyrient

GaN（窒化ガリウム）技術の浸透

EVエコシステム

電力エレクトロニクス

# 迫り来る新たな規制ネットワークによる「包囲網」

米国下院で審議が進行するこれらの一連の法案は、ハードウェアの輸出規制だけでなく、クラウド経由でのアクセス権限までも**完全に遮断する恒久的な分断構造**を意図している。



# 【Synthesis】2026年 半導体市場の新戦略フレームワーク

膨張するAI需要は「地政学的な壁」に衝突することで、かつてのような単一グローバル供給網ではなく、高度に分散・二重化された「多極的サプライチェーン」へと強制的に変容させられている。

## サプライチェーンの分散・両建て

Intel再起 / MediaTek併用

## 地政学的・規制の壁

MATCH Act / 中国の自立化

## 爆発するAI・推論需要

TSMC 1.5兆ドル / Fractile



# 経営層のための4つの戦略的インプリケーション（Key Takeaways）



## Intel Foundryの再評価

政府の後押しとApple獲得により、先端ファウンドリとしての地位は再構築されつつある。調達戦略の見直しが必要。



## AI市場の構造的成長

TSMCのデータが証明する通り、AI需要は一時的ブームではない。長期的なキャパシティ確保が急務。



## 推論（Inference）への資金シフト

より実用的・低コストなAI運用インフラへ焦点が移動した。エッジ・専用チップ技術へのアライアンスを強化せよ。



## 地政学リスクの恒久化

中国市場の国産チップ主導への移行は不可逆。特殊な規制環境下でのグローバルビジネスモデルの再構築が求められる。